



Lötdraht KS115, Sn95,5Ag3,8Cu0,7 -
FLOWTIN TSC, RE M1, 0.3mm, 250g

Artikel-Nr: 574101
Lagerbest Sofort Lieferbar (4)
and:

CHF 118.80

5+	~~CHF 118.80~~	CHF 112.70	(5% sparen)
10+	~~CHF 112.70~~	CHF 105.40	(11% sparen)
20+	~~CHF 105.40~~	CHF 99.00	(16% sparen)

Beschreibung

Die Elektroniklötdrähte der Stannol KS-Serie sind Produkte, die für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen entwickelt wurden. Sie erfüllen somit Ansprüche, die bei der industriellen Fertigung, dem maschinellen Löten sowie beim Reparatur- und Nachlöten an einen Lötendraht gestellt werden. Stannol KS115 enthält ein halogenaktiviertes und Kolophonium freies Flussmittel mit synthetischen Harzen. Der Stannol KS100 basiert auf den gleichen Harzen, ist jedoch halogenfrei aktiviert. Alle Flussmitteltypen kombinieren in hervorragender Weise hohe Aktivität und thermische Belastbarkeit mit hellen, harzigen, festen und elektrisch sicheren Rückständen. Das Stannol Drahtflussmittel KS115 entspricht J-STD-004. Durch die hohe Aktivierung (1,5%) wird das Drahtflussmittel in die Klasse REM1 eingestuft. Der Stannol KS100 entspricht nach J-STD-004 Typ RELO

Technische Daten

Die verwendeten synthetischen Harze bieten im Gegensatz zu Naturkolophonium im Flussmittel folgende Vorteile:

- Aktives Flussmittel (Schnelle Benetzung von Löttoberflächen; kürzere Taktzeiten)
- Helle Rückstände (Geringer thermischer Abbau des Harzes bei hohen Temperaturen; optisch guter Eindruck)
- Feste Rückstände (Hoher Erweichungspunkt; chemisch-physikalische Sicherheit)
- Weniger Spritzer (höhere Viskosität des Flussmittels bei Löttemperatur; geringere Verschmutzung)
- Weniger Dämpfe (Geringe Zersetzung und Verdampfung bei hohen Temperaturen; verminderte Arbeitsplatzbelastung und Kontamination der Umgebung der Lötstelle)

ANWENDUNGSBEREICHE

Stannol Lötdrähte KS115 und KS100 können für Hand- und Maschinenlötung im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik eingesetzt werden.

Zusätzliche Information

Hersteller	STANNOL
Produktserie	KS115
Flussmittel	REM1

Bleihaltig	Nein
Halogenfrei	Nein
Fairtin	Nein
Legierung	Zinn/Silber/Kupfer
Anteil Zinn (Sn) in %	95.5
Anteil Silber (Ag) in %	3.8
Anteil Kupfer (Cu) in %	0.7
Durchmesser (mm)	0.3
Spulengrösse (g)	250
Schmelztemperatur (°C)	217